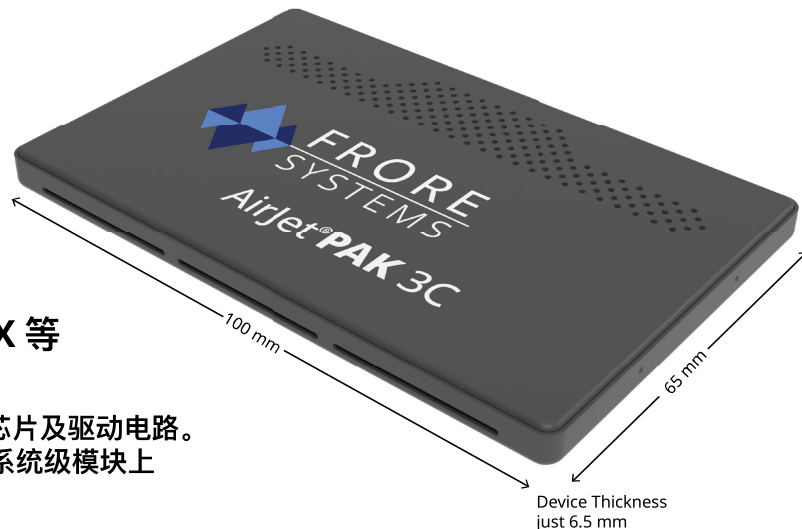




AirJet® PAK 3C

专为配合释放英伟达 Jetson Orin Nano/NX 等 AI 系统级模块性能而设计。

- 完全独立、即插即用的散热解决方案内含多个 AirJet 芯片及驱动电路。
- 可直接安装在类似 NVIDIA's Jetson Orin Nano/NX 系统级模块上
- 自主运行。
- 轻薄、静音、无振动、防尘且防溅水。
- 在 NVIDIA Jetson 平台上，最高支持 80 TOPS 的算力。
- 在环境温度 25°C、结温 115°C 的条件下，最高可散发 24 瓦的热量。



在计算领域，热量是最大的瓶颈，而散热则是如今计算领域中唯一仍在沿用的属于上个世纪的技术。为了满足人工智能所需要的大规模处理，要大幅改进散热技术的需求正在迅速增长。此外，据预测，到 2030 年，对边缘人工智能的需求预计将增长超过 300%，并且短期内这种需求并不会减缓。

AirJet PAK 是全球首款针对边缘 AI 的固态主动散热解决方案，它采用了革命性的**AirJet** 固态主动散热芯片。**AirJet PAK 3C** 是一款完全集成一体化完全独立的主动式散热器模块。

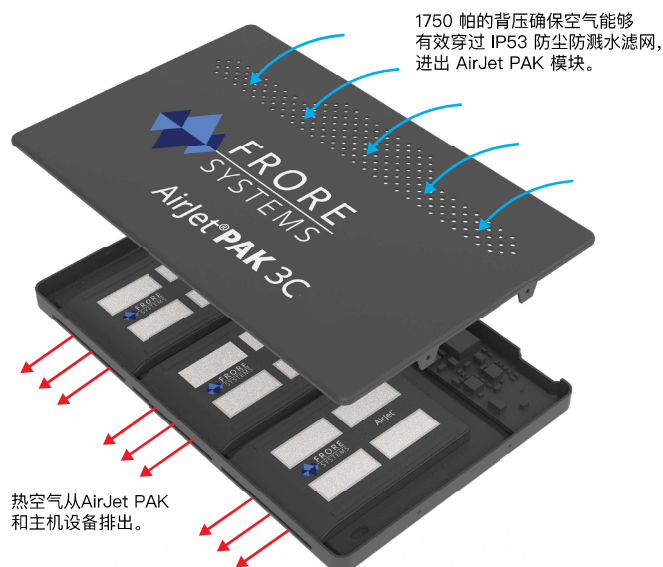
强劲散热能力——AirJet PAK 3C 集成到散热板温度 90°C 的计算平台中时，能够以 26 dBA 的静音水平移除 24 瓦的净热量，而最大功耗仅 4 瓦，其性能超越了同类紧凑型边缘 AI 设备中的风扇散热器。

释放 AI 性能——AirJet PAK 3C 厚度仅为 6.5 毫米，专为与 Jetson Orin Nano, NX 和 AGX Orin 等模组打造，这款超薄设计为制造商带来了全新的可能性，能够满足用户对更高性能、更紧凑、静音、无振动且防尘设备的需求。

AirJet PAK	NVIDIA Jetson	TOPS	Power
AirJet PAK 3C	Orin NX 16GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	80	20 W
2x AirJet PAK 3C	Orin NX 16GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	157	40 W

每个 AirJet PAK 3C 模组均内置 3 块 AirJet 芯片——全球首款固态主动散热芯片。

指标	AirJet® PAK 3C
总净散热量 (环境温度 25°C, 结温 115°C 的条件下)	24 W
最大噪音 (距离 50 厘米处)	26 dBA
最大功耗	4 W
背压	1750 Pa
尺寸 (宽 × 长 × 厚)	100 x 65 x 6.5 mm
重量	70 g



AirJet® PAK 3C

持续稳定的性能与可靠性

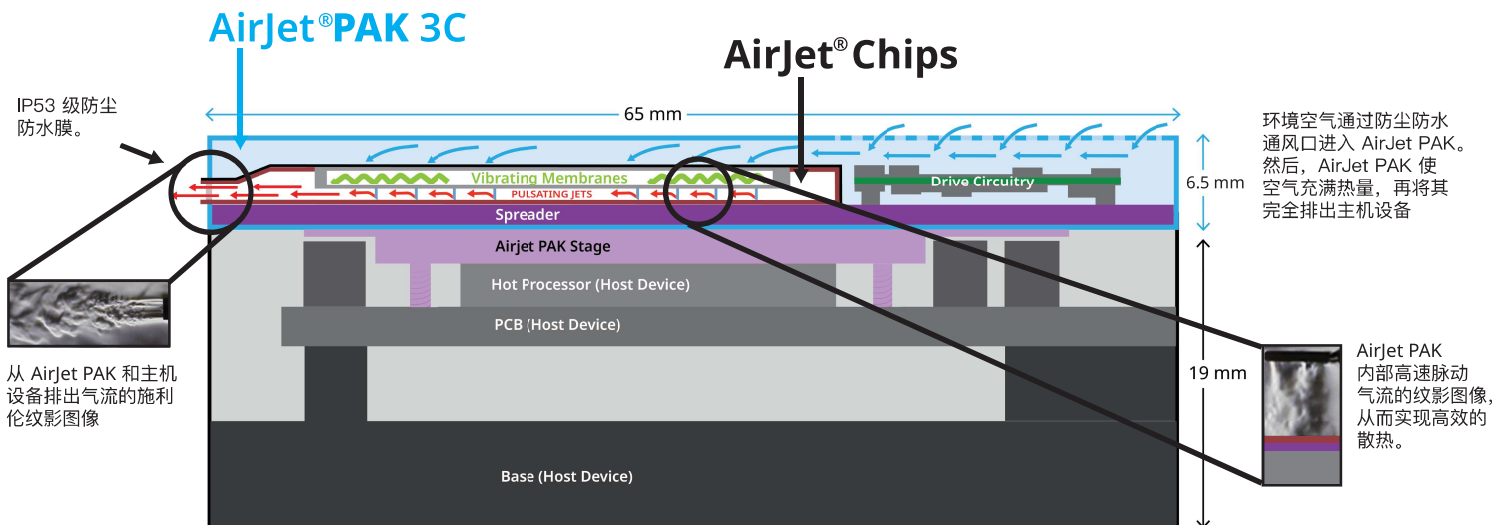
AirJet PAK 可产生 1750 帕的背压，即使通风口被 IP53 防尘防水过滤器覆盖，也能确保空气有效进出模块。结合 AirJet PAK 的智能自清洁功能，进一步提升了可靠性，确保其散热性能持续稳定，从而使具备防尘功能的主机设备也能保持高性能运行。

AirJet PAK 通过自主驱动，运用热感技术 (Thermoception) 独立感知周围温度。这一创新技术让 AirJet PAK 无需依赖主机设备内的温度传感器，就能优化自身性能，实现高效散热。AirJet PAK 只需从主机设备获取额定电源，就能助力处理器发挥卓越性能。

在如今的设备中，决定性能的往往不只是处理器的先进程度，散热解决方案的能力同样至关重要。

得益于 AirJet PAK 3C，紧凑型边缘人工智能电子设备如今终于能够兑现尖端人工智能技术的承诺。实现更多。

Cross Section of AirJet® PAK Cartridge Inside Host Device



AirJet PAK 通过 4 针 Molex PicoBlade 连接器，由主机设备中的应用板供电。

设计用于与 NVIDIA Jetson Orin Nano & NX 等系统级模块协作

AirJet PAK 3C 散热量随环境温度而变化

